



Intel® Core™ i7-4770TE Processor

8M Cache, up to 3.30 GHz

Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ i7 czwartej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Haswell poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Embedded
- Numer procesora i7-4770TE
- Stan Launched
- Data rozpoczęcia Q2'13
- Litografia 22 nm
- Rekomendowana cena klienta \$303.00
- Warunki użytkowania Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet

Wydajność

- Liczba rdzeni 4
- Liczba wątków 8
- Bazowa częstotliwość procesora 2,30 GHz
- Maks. częstotliwość turbo 3,30 GHz
- Cache 8 MB SmartCache
- Szybkość magistrali 5 GT/s DMI
- TDP 45 W

Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Tak
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)
- Opis produktu [Wyświetl teraz](#)
- Adres URL dodatkowych informacji [Wyświetl teraz](#)

Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 32 GB
- Rodzaje pamięci DDR3 1333/1600
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 25,6 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Nie

Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Grafika HD Intel® 4600
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1,00 GHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 2 GB

- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/VGA
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4) ‡ N/A
- Obsługa DirectX* 11.2/12
- Obsługa OpenGL* 4.3
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Interfejs Intel® Flexible Display (Intel® FDI) Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy ‡ 3

Opcje rozszerzeń

- Skalowalność 1S Only
- Wersja PCI Express 3.0
- Liczba konfiguracji PCI Express ‡ 1x16
- Maksymalna liczba linii PCI Express 16

Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCLGA1150
- Maks. konfiguracja procesora 1
- Specyfikacja systemu Thermal Solution PCG 2013B
- T_{CASE} 71.45°C
- Wymiary obudowy 37.5mm x 37.5mm (LGA1150)

Technologie zaawansowane

- Technologia Intel® Turbo Boost ‡ 2.0
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy ‡ Tak
- Technologia Intel® Hyper-Threading ‡ Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) ‡ Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) ‡ Tak
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ Tak
- Intel® TSX-NI Nie
- Intel® 64 ‡ Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Technologia Intel® ochrony tożsamości ‡ Tak

Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution ‡ Tak
- Funkcje Execute Disable Bit ‡ Tak
- Technologia Anti-Theft Tak